证券代码：688099　　证券简称：晶晨股份

晶晨半导体（上海）股份有限公司
2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,743,714,388.05	57.62	7,135,175,982.34	40.70
利润总额	681,449,566.68	200.62	1,282,230,253.06	81.05
归属于上市公司股东的净利润	682,768,095.61	239.35	1,293,559,196.18	85.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	673,820,873.93	290.57	1,233,941,413.78	96.01
经营活动产生的现金流量净额	-268,828,858.45	-177.89	-770,985,711.83	不适用

基本每股收益（元/股）	1.62	237.50	3.07	84.94
稀释每股收益（元/股）	1.61	235.42	3.05	84.85
加权平均净资产收益率（%）	8.20	增加 5.36 个百分点	16.15	增加 5.89 个百分点
研发投入合计	479,794,517.25	25.15	1,393,389,561.85	24.63
研发投入占营业收入的比例（%）	17.49	减少 4.53 个百分点	19.53	减少 2.52 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,869,106,102.52	8,644,115,130.99		25.74
归属于上市公司股东的所有者权益	8,677,840,778.12	7,346,054,146.87		18.13

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

报告期内，全球半导体市场在 AI 算力需求驱动下快速扩张，呈现“结构性景气”特征：云端算力、存储芯片和先进制程高景气，传统消费电子需求则不同程度受到 DRAM/NAND 涨价影响。消费类芯片产业链仍需面临存储及核心原材料供应紧张、价格波动、客户采购节奏变化等不确定性因素的挑战。

2026 年第三季度，公司延续上半年以来的经营趋势，主营业务收入平稳增长，前三季度公司合计实现营业收入 71.35 亿元，同比增长 40.70%。主力产品线智能电视 SoC 芯片业务持续增长，成为公司业务增长的主要引擎。本季度，公司实现营业收入 27.44 亿元，同比增长 57.62%，环比增长 9.93%，本年以来逐季递增。

面对全球半导体产业链结构性分化、存储及核心原材料价格波动、消费类电子需求变化等外部环境，公司通过合理调整产品售价、持续提高经营效率、前瞻布局供应链管理、加强全球渠道协同，保障了合理健康的毛利率和稳定的盈利能力。2026 年前三季度公司实现综合毛利率 41.92%，同比上升 4.80 个百分点；实现归属于母公司所有者的净利润 12.94 亿元，同比增长 85.38%；其中，第三季度单季实现归属于母公司所有者的净利润 6.83 亿元，同比增长 239.35%，环比增长 56.03%，继上季度创下历史高点后再度刷新纪录。同时，公司因股权激励确认的股份支付费用为 1.06 亿元，对归属于母公司所有者的净利润的影响为 1.02 亿元（已考虑相关税费影响），剔除上述股份支付费用影响后，2026 年前三季度归属于母公司所有者的净利润 13.96 亿元，其中第三季度归属于母公司所有者的净利润 7.16 亿元。

从费用端来看，前三季度公司发生销售费用、管理费用、研发费用三项期间费用合计 16.04 亿元，同比增加 3.43 亿元，期间费用增长主要系加大研发投入，研发费用上升所致。本期发生研发费用 13.93 亿元，较去年同期增加 2.75 亿元，主要由于团队收购及人员扩张致薪酬成本上升、2026 年股权激励计划落地致股份支付费用增加、新产品研发推进带动材料及折旧摊销同比增加。

截止 2026 年 9 月 30 日，公司存货账面价值为 50.53 亿元，较年初 25.28 亿元大幅上升 99.92%，较二季度末 35.39 亿元上升 42.81%，呈现持续上升趋势。存货规模有所增长，主要系公司业务规模持续扩大、营业收入稳步增长，为保障产品按期交付及供应链稳定而进行的正常生产备货所致。同时，公司基于谨慎性原则，从严按照会计政策对存货计提了跌价准备，公司前三季度资产减值损失较去年同期增加 0.80 亿元。

结合公司前三季度的经营表现与策略执行，特此做如下全面分析：

（一）电视 SoC 业务：量价齐升，合封存储芯片带来的涨价及毛利率改善，结合产品高端突破驱动了业绩增长

公司前三季度业绩的主要贡献来源于电视 SoC 业务的强劲表现，呈现量价齐升的良好态势。电视 SoC 芯片合封存储芯片带来的涨价，叠加产品结构的持续优化，推动电视 SoC 毛利率较去年同期有明显提升。

新客户拓展方面，公司成功打入三星电视供应链体系，目前双方正围绕公司芯片平台开展软件生态适配工作，计划于 2026 年第四季度实现批量供货，并期待在 2027 年斩获可观的市场份额。三星作为全球电视市场的标杆品牌，其供应链准入不仅标志着公司产品竞争力获得国际一流客户认可，更将为电视业务的长期稳健增长注入强劲动能。

同时，依托 TCL 与索尼在家庭娱乐领域的战略合作及合资项目落地契机，公司已顺利切入索尼电视品牌供应链，相关项目预计于 2027 年第一季度完成量产定型。

此外，随着 AV2 视频编码标准正式推出，公司加速推进生态协同。目前多家国内外知名电视机客户正与公司紧密对接，计划待公司 AV2 芯片完成研发后启动方案适配及深度合作。

（二）机顶盒 SoC 业务：存储成本激增影响本年度需求，新集采招标带来改善机会，中屏业务打开新增长空间

2026 年前三季度，国内机顶盒业务受上游存储芯片涨价影响较为明显，较高的成本压力对公司智能机顶盒业务需求产生明显的抑制。海外机顶盒市场也受到存储成本上涨影响。值得关注的是，展望第四季度，机顶盒业务已出现回暖迹象。国内三大运营商招标会在年内陆续启动，为公司机顶盒业务明年的反弹提供有力的支撑。随着国内广电总局电视一体化政策的推广，更加便捷用户使用的插入式机顶盒也有望取代传统的智能机顶盒形态，从而加速国内存量机顶盒替换。

与此同时，国内运营商正积极推行 Token 经营策略，加快抢占家庭 AI 入口，AI 中屏（产品形态类似 Apple Home View）成为重点发力方向。随着该类产品形态和体验不断优化，市场接受度持续提升，出货规模预计会稳步抬升，预计 2026 年完成集采招标 1,000 万台，2027 年行业整体出货量有望突破

1,500 万台。就已开标案来看，公司份额占比超过 50%。随着运营商 AI 中屏集采持续推进，公司相关 AI SoC 加 Wi-Fi 6 一体化套片需求将进一步增长。

（三）AIoT SoC 业务：战略新产品为公司打开第二增长曲线

端侧 SoC 赛道在分化中走出独立增长曲线，智能视觉、智能家居、车载等 AIoT 相关场景对本地 NPU 算力的需求持续释放，增长前景广阔。

公司前瞻性布局端侧 AI 算力技术，持续推动自研 NPU 等核心模块的优化迭代与集成。截至目前，公司已有超过 20 款芯片搭载自研 NPU 单元。

在此前荷兰举办的 IBC（国际广播）2026 展会上，公司积极参展，向全球运营商及重要客户展示 AI 相关配套技术与落地应用，共探行业发展新方向。同时，公司携手华曦达、创维等合作伙伴，首发推出了基于晶晨芯片平台的 AI 家庭显示终端、AI 流媒体盒子及 AI 数码相框等新一代边缘 AI 家庭设备。

公司本年度重磅推出高算力通用 AI 端侧平台芯片 A311Y3（A9），目前已正式量产，并在多个应用领域实现商业化突破：

在商用显示领域，A311Y3 已进入十数家头部整机商的量产与试产阶段，产品已完成 Android 16 与 EDLA 生态适配，为商显产品迭代周期做好了准备。在机器人领域，公司与高性能 MCU 公司先楫半导体完成了实时操作系统与基于 A311Y3 的端侧 AI 联合验证，签署了战略合作协议，共同推出了具备“感知+运动控制”场景一体化能力的平台方案。在 AI NAS，本地多模态 AI 相册等端侧 AI 应用领域，A311Y3 已随多个客户新品进入到量产阶段，逐步拓展家庭边缘算力应用场景。在开发者生态方面，公司已与主流开源板卡厂商深度合作，已支持 Yocto、Debian、Armbian、Android 多 OS，已上线 Amlogic AI 开发者门户（amlogic-nn.github.io），Amlogic-NN 开源组织同步登陆 GitHub，开发者生态持续完善。此外，A311Y3 在智能座舱、游戏盒子等新场景多点开花，端侧 AI 平台化战略实现稳步推进。

展望后续，随着搭载 A311Y3 的各种新品项目落地，公司端侧 AI 芯片产品组合的不断丰富，以及最终 AI 模型进化及端侧终端的爆发放量，公司的端侧 AI 产品线将为公司打开第二增长曲线。

（四）其他新产品：显示器芯片、连接与通信芯片持续拓展

搭载公司显示器芯片的小米 FHD300 24.5 寸游戏显示器已正式进入量产，并计划于“双 11”期间上市销售。后续多家品牌客户的多款不同规格显示器也即将进入量产阶段。同时公司持续投入新款显示器芯片的研发，预计到 2027 年上半年，公司将基本形成覆盖高、中、低端的完整显示器芯片产品矩阵。

WiFi 产品方面，公司新一代 Wi-Fi 6 1x1 芯片已按计划实现量产，其中 SDIO 接口版本率先落地，已获得多个项目定点，覆盖智能音箱、Soundbar、OTT 及多媒体设备等应用场景，USB 接口版本预计将于

今年 10 月量产。随着双接口布局逐步完善，相关产品有望进入快速放量阶段。Wi-Fi 6 2x2 芯片最新版本聚焦降本增效，预计将于今年年底送样，有望在成本、集成度及量产良率等方面实现显著改善。

蜂窝通信产品方面，公司 NH2（LTE Cat.1）第二版芯片已顺利回片，目前正开展功能、射频性能及系统兼容性测试，整体进展符合预期，已进入关键验证阶段，预计将于 2027 年实现规模收入。与此同时，LTE Cat.4 项目开发工作正按计划推进；LTE Cat4+ 5G RedCap 相关产品也已启动研发。

（五）全年展望及未来发展

展望全年，本年度营业收入有望实现年度预告中 25%-45%同比增长的上限，力争突破 100 亿元。

未来，公司各业务板块将继续稳步推进：电视 SoC 业务方面，随着高端产品持续放量、三星等战略级客户逐步贡献增量，该产品线有望为公司收入和利润持续增长提供核心驱动力。机顶盒业务方面，随着存储成本压力逐步缓解、国内三大运营商招标陆续启动，机顶盒业务将迎来逐步回暖的积极变化。AIoT 业务方面，公司持续有战略级别端侧 AI 新产品成功完成研发并完成市场导入，随着 AI 模型进化，端侧 AI 终端产品不断涌现，各应用场景落地，用户使用习惯的养成，该产品线将为公司 2027 年业绩成长提供新动能，也将进一步拓展公司未来的成长空间。显示器芯片、连接与通信芯片等产品线也将加速新产品的商业化进程，逐步兑现业绩贡献。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1.72	-8,896.38	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,481,804.51	21,683,765.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-5,319,209.58	38,708,175.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,149,324.34	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,655.15	392,755.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2.74	128,405.40	稳岗补贴等
减：所得税影响额	-2,757,967.14	2,154,640.83	
少数股东权益影响额（税后）		1,281,107.48	
合计	8,947,221.68	59,617,782.40	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	57.62	主要系公司主力产品持续放量，高端系列产品加速导入头部终
营业收入_年初至报告期末	40.70	

		端客户，带动营业收入实现增长。
利润总额_本报告期	200.62	主要系公司主营业务收入平稳增长，同时优化定价与供应链管理，持续提升经营效率，归母净利润实现增长。
利润总额_年初至报告期末	81.05	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	239.35	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	85.38	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	290.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	96.01	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-177.89	主要系公司收入增长及原材料涨价推动采购付现支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_本报告期	237.50	主要系公司归属于上市公司股东的净利润增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	84.94	
稀释每股收益_本报告期	235.42	
稀释每股收益_年初至报告期末	84.85	
加权平均净资产收益率_本报告期	增加 5.36 个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加 5.89 个百分点	

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Amlogic （Hong Kong）Limited	境外法人	79,441,087	18.77	0	0	无	0
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	境内非国有法人	20,555,950	4.86	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	19,379,758	4.58	0	0	无	0

招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,385,444	3.40	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	11,851,603	2.80	0	0	无	0
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	10,065,983	2.38	0	0	无	0
兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	其他	7,690,767	1.82	0	0	无	0
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,033,215	1.66	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,542,894	1.55	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	6,381,004	1.51	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Amlogic （Hong Kong） Limited	79,441,087	人民币普通股	79,441,087
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	20,555,950	人民币普通股	20,555,950
香港中央结算有限公司	19,379,758	人民币普通股	19,379,758
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	14,385,444	人民币普通股	14,385,444
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	11,851,603	人民币普通股	11,851,603

中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	10,065,983	人民币普通股	10,065,983
兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	7,690,767	人民币普通股	7,690,767
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,033,215	人民币普通股	7,033,215
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,542,894	人民币普通股	6,542,894
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	6,381,004	人民币普通股	6,381,004
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东 Amlogic（Hong Kong）Limited 与其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述 A 股股东不存在参与融资融券、转融通业务的情况。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：晶晨半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,645,459,892.53	2,592,669,479.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,311,466.93	400,551,532.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	783,411,389.16	334,848,262.10
应收款项融资		
预付款项	290,053,126.16	390,684,209.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,729,182.33	36,075,477.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,053,391,520.20	2,527,697,362.60
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,056,033.55	4,176,037.60
其他流动资产	409,998,192.07	396,304,955.98
流动资产合计	8,594,410,802.93	6,683,007,317.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	185,358,052.44	148,786,360.61
其他债权投资		
长期应收款	1,043,632.35	1,811,250.25
长期股权投资	87,395,761.20	94,898,291.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	599,246,211.94	548,347,529.45
投资性房地产	87,081,077.20	91,913,301.75
固定资产	368,508,200.28	385,017,896.74
在建工程	74,342,346.87	78,078,482.45

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,987,974.29	19,048,203.42
无形资产	438,469,662.53	151,498,581.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	302,700,760.09	223,781,481.00
递延所得税资产	96,798,293.25	53,373,456.55
其他非流动资产	12,763,327.15	164,552,978.49
非流动资产合计	2,274,695,299.59	1,961,107,813.70
资产总计	10,869,106,102.52	8,644,115,130.99
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	632,184.50	62,650.81
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,289,979,280.18	569,603,763.85
预收款项		
合同负债	138,253,149.60	121,273,703.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	208,543,370.81	198,800,550.98
应交税费	84,741,972.44	59,983,236.08
其他应付款	272,798,099.34	147,000,991.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,731,385.99	36,442,095.53
其他流动负债	55,744,497.92	68,323,869.54
流动负债合计	2,093,423,940.78	1,201,490,861.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,509,329.52	9,127,033.24
长期应付款	9,432,132.02	10,384,207.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,707,612.53	47,146,119.74
递延所得税负债	16,321.70	13,889.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,665,395.77	66,671,250.31
负债合计	2,160,089,336.55	1,268,162,112.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	423,319,995.00	421,165,613.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,193,477,440.29	3,008,210,739.03
减：库存股	100,094,123.78	80,016,443.97
其他综合收益	-60,599,608.05	-15,449,864.47
专项储备		
盈余公积	210,582,806.50	210,582,806.50
一般风险准备		
未分配利润	5,011,154,268.16	3,801,561,296.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,677,840,778.12	7,346,054,146.87
少数股东权益	31,175,987.85	29,898,872.05
所有者权益（或股东权益）合计	8,709,016,765.97	7,375,953,018.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,869,106,102.52	8,644,115,130.99

公司负责人：John Zhong　　主管会计工作负责人：高静薇　　会计机构负责人：高静薇

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：晶晨半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	7,135,175,982.34	5,071,144,502.71
其中：营业收入	7,135,175,982.34	5,071,144,502.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,828,417,264.60	4,428,413,196.93

其中：营业成本	4,144,117,122.05	3,188,602,766.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,455,851.76	15,362,546.26
销售费用	74,766,809.04	47,642,616.75
管理费用	136,150,846.77	95,297,695.85
研发费用	1,393,389,561.85	1,117,997,439.03
财务费用	70,537,073.13	-36,489,867.12
其中：利息费用	621,830.48	782,255.69
利息收入	32,423,583.38	70,372,510.72
加：其他收益	16,746,372.17	13,878,966.77
投资收益（损失以“-”号填列）	19,877,531.29	42,282,149.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,502,530.40	3,989,752.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,830,644.56	11,476,491.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,080,774.67	-643,247.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,435,421.93	-1,055,456.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,598.94	13,721.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,279,688,470.22	708,683,930.72
加：营业外收入	2,772,960.59	25,394.56
减：营业外支出	231,177.75	492,833.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,282,230,253.06	708,216,491.37
减：所得税费用	-12,609,244.81	13,180,866.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,294,839,497.87	695,035,625.12
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,294,839,497.87	695,035,625.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,293,559,196.18	697,770,426.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,280,301.69	-2,734,801.84
六、其他综合收益的税后净额	-45,152,929.47	-9,727,502.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,149,743.58	-9,726,868.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-45,149,743.58	-9,726,868.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-45,149,743.58	-9,726,868.41
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,185.89	-634.33
七、综合收益总额	1,249,686,568.40	685,308,122.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,248,409,452.60	688,043,558.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,277,115.80	-2,735,436.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	3.07	1.66
（二）稀释每股收益（元/股）	3.05	1.65

公司负责人：John Zhong　　主管会计工作负责人：高静薇　　会计机构负责人：高静薇

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：晶晨半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,775,492,556.26	5,191,641,855.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	300,095,176.67	244,095,755.76
收到其他与经营活动有关的现金	47,500,771.05	38,972,945.04
经营活动现金流入小计	7,123,088,503.98	5,474,710,556.08
购买商品、接受劳务支付的现金	6,658,486,857.30	4,694,069,439.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	981,436,513.73	875,824,291.97
支付的各项税费	64,682,733.65	54,841,567.64
支付其他与经营活动有关的现金	189,468,111.13	137,155,749.85
经营活动现金流出小计	7,894,074,215.81	5,761,891,049.14
经营活动产生的现金流量净额	-770,985,711.83	-287,180,493.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,290,922,998.68	4,574,523,973.58
取得投资收益收到的现金	57,713,757.89	79,779,649.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,555.15	1,512,807.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		753,606.71
收到其他与投资活动有关的现金	1,752,810,000.00	580,972,800.00

投资活动现金流入小计	4,101,551,311.72	5,237,542,837.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,768,964.24	251,461,717.31
投资支付的现金	1,129,780,899.75	3,761,129,685.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	111,338,907.63	
支付其他与投资活动有关的现金	2,021,715,248.80	580,857,600.00
投资活动现金流出小计	3,510,604,020.42	4,593,449,002.95
投资活动产生的现金流量净额	590,947,291.30	644,093,834.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,638,881.67	129,423,613.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,638,881.67	129,423,613.30
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,749,346.14	6,279.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,261,782.13	67,924,115.75
筹资活动现金流出小计	119,011,128.27	67,930,394.82
筹资活动产生的现金流量净额	-37,372,246.60	61,493,218.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,933,111.75	-7,822,373.70
五、现金及现金等价物净增加额	-250,343,778.88	410,584,186.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,170,463,743.54	809,767,864.97
六、期末现金及现金等价物余额	920,119,964.66	1,220,352,051.36

公司负责人：John Zhong　　主管会计工作负责人：高静薇　　会计机构负责人：高静薇

（三） 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日